

晶晨半导体（上海）股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

提高上市公司质量、增强投资者回报是上市公司对投资者的应尽之责，为践行“以投资者为本”的理念，维护全体股东利益，切实增强投资者对资本市场的信心，有效吸引更多资金参与，结合自身发展战略和经营情况，晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）持续开展“提质增效重回报”专项行动，现对2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行评估，并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

一、聚焦经营主业，积极进行市场开拓

公司近年来重点投入的新产品批量上市，快速打开市场局面，在全球化市场的持续耕耘逐步进入收获期，2025年经营情况持续向好。

1、经营业绩稳步增长。2025年，公司营业收入、归属于母公司所有者的净利润、芯片销量均创历史新高，实现营业收入67.93亿元，同比增加8.67亿元；归属于母公司所有者的净利润8.73亿元，同比增加0.51亿元；全年芯片销量超1.74亿颗，同比增加超0.31亿颗。

2、经营质量持续改善。2025年公司综合毛利率逐季攀升，季度综合毛利率分别为36.23%、37.29%、37.74%、40.46%，2025年全年综合毛利率37.97%，较2024年提升1.42个百分点。毛利率的持续改善主要得益于：一是产品结构持续优化，高毛利产品占比提升；二是运营效率稳步提升，精细化管控成本费用；三是规模效应持续显现。

3、战略新品规模化商用。2025年是公司新产品大规模商用年，多个重点投入的战略性产品实现规模化出货：端侧AI芯片，出货量超2,000万颗，同比增长近160%，目前已有超20款芯片搭载公司自研的端侧智能算力单元，产品适配主流端

侧大模型及多元创新场景，并与全球头部及新兴客户深度合作；6nm 芯片，2025 年实现销量近 900 万颗，已通过大规模商用验证，技术成熟度、产品稳定性均已通过国际化客户和市场检验，客户覆盖 To B 端全球运营商市场及 To C 端全球著名消费电子客户；Wi-Fi 6 芯片，2025 年实现销量超 700 万颗，在 W 系列中占比从 2024 年的近 11%快速提升至 37%，已成为无线连接核心产品；智能视觉芯片，2025 年实现销量超 400 万颗，同比增长超 80%，均已成为公司主力产品线。

4、全球化渠道优势显现。公司多年来全球化多渠道市场拓展的成果正逐步显现。在 To B 端，公司已与全球各主要经济区域的近 270 家运营商建立合作关系；在 To C 端，2025 年与多个全球著名消费电子客户推出多款新产品。2025 年第四季度，公司营收同比增长约 34%，海内外渠道协同放量效应显著。

2026 年，公司将围绕“端侧智能+算力+通信”核心战略，持续推进运营效率提升，推动新产品快速高质量上市，实现研发成果高效转化，力争实现营业收入 25%-45%的同比增长。

1、聚焦核心赛道，推动端侧 AI 规模化增长

端侧 AI 是公司核心战略赛道，面对端侧智能的历史性机遇，2026 年公司将采取以下举措：

(1) 持续扩大端侧 AI 芯片出货规模。公司已将 6nm 制程延伸至更高算力的通用端侧平台，2026 年，预计 6nm 芯片出货量目标突破 3,000 万颗，较 2025 年增长 233%，规模化放量将进一步带动公司业绩增长。新产品将于 2026 年推出，产品矩阵更加完善。

(2) 拓展端侧 AI 应用场景。公司目前已有超 20 款芯片搭载自研的端侧智能算力单元，已与全球头部及新兴客户深度合作。2026 年将持续拓展更多应用场景，打造差异化竞争力，助力公司进一步构建核心技术壁垒。

(3) 强化端侧智能解决方案能力。通过芯迈微团队的加入，公司将构筑“蜂窝通信+光通信+Wi-Fi”的多维通信技术栈，最终形成以“端侧智能+算力+通信”为主干、软硬件一体为支撑，面向多场景，具有独特竞争力的端侧智能解决方案。

2、优化产品结构，提升盈利质量

2026 年公司将着力优化产品结构，提升盈利质量：

(1) 提升高端产品占比。通过扩大 6nm 芯片、Wi-Fi 6 芯片、智能视觉芯片等高端产品的销售规模，提升新产品及高端产品在收入结构中的占比。

(2) 持续推动运营效率提升。在 2024 年“运营效率提升年”、2025 年持续推进的基础上，2026 年将继续落实运营效率提升行动项，推动营运质量持续改善。

(3) 应对存储市场波动。2025 年下半年面对全球存储市场的剧烈变化，公司实施了前瞻性、合理有序的备货安排，有效保障了客户需求。2026 年将继续合理安排存储芯片备货与供应，并优化相关 SoC 产品价格策略，保持经营的可持续性。

3、深化全球化渠道布局

2026 年，公司将进一步巩固在既有优势领域与现有客户的合作，并将既往成功经验延伸至新客户、新区域：

(1) To B 端：深耕全球近 270 家运营商客户，积极拓展优势产品的新的应用场景，不断提升优势产品的市场占有率。

(2) To C 端：公司 2025 年与多个全球著名消费电子客户推出多款新产品，2026 年将持续扩大与全球消费电子客户合作的深度与广度。

(3) 区域拓展：视市场及客户需求统筹海内外渠道资源，实现 B/C 端业务协同发展，筑牢增长根基。

二、提升科技创新能力，保持研发团队积极性

公司始终秉持“研发能力为第一生产力”的经营理念，2025 年公司继续保持高强度研发投入，全年研发费用约 15.52 亿元，较 2024 年增加 1.99 亿元，近三年累计研发费用 41.87 亿元。多款在研产品取得积极进展：其中，覆盖端侧智能领域和智能汽车领域的新一代高算力 6nm 芯片、Monitor 系列的首款芯片，高算力智能视觉芯片均已流片；集成公司多项 SoC 技术的 Wi-Fi 路由芯片及 Wi-Fi 6 1*1 高速低功耗芯片，均已成功回片，目前处于测试阶段。同时，2025 年 9 月公司宣布

收购芯迈微半导体，将助力公司构筑“蜂窝通信+光通信+Wi-Fi”的多维通信技术栈与产品矩阵。

2025 年度，公司新申请知识产权 118 件，其中发明专利申请 98 件；新获得授权 49 件，其中发明专利授权 23 件。截至 2025 年年末公司研发人员达 1,684 人，较上期净增 110 人，增幅约 7.0%；研发人员占公司总人数的比例由上期的 86.11% 提升至 86.58%，提升了 0.47 个百分点。2025 年度研发人员薪酬合计 106,061.55 万元，同比增长约 1.93%。2025 年度公司在保持高研发投入强度的同时，优化人才梯队结构，为后续技术攻关储备充足的人力资源。

公司始终保持“瞄准大市场、确定性机会、集中投入、高质量研发”的原则，2025 年公司多款在研产品取得积极进展：新一代高算力 6nm 芯片、Monitor 系列首款芯片、高算力智能视觉芯片均已流片；Wi-Fi 路由芯片、Wi-Fi 6 1*1 高速低功耗芯片已回片测试。

2026 年，公司将采取以下具体的计划与措施，持续提升科技创新能力，保持研发团队积极性。

1、推动研发成果高效转化

公司研发紧密贴合市场需求，在研产品均为高潜力赛道产品，流片、回片进展顺利，后续将推动新产品快速高质量上市，实现研发成果高效转化。基于 6nm 制程技术推出的更高算力的通用端侧平台系列，面向更广泛的应用场景，满足端侧大模型部署需求；进一步拓展高端市场，陆续推出 T 系列高端芯片，提升产品在高端市场的渗透率；进一步推出 Wi-Fi 路由芯片及 Wi-Fi 6 1*1 高速低功耗芯片，丰富无线连接产品线，2026 年 Wi-Fi 6 芯片出货量目标突破 1,000 万颗；通过 Monitor 系列首款芯片，进一步拓展智能显示领域，开辟新的增长点；利用高算力智能视觉芯片，满足智能视觉领域对高算力、高性能的需求，进一步提升市场份额。

2、持续人才培养，激励员工共担共享

公司建立了健全的长效激励机制，以吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性。截至 2025 年 12 月 31 日，公司稳步落实五期股权激励计划（2019

年、2021年、2023年及2023年第二期、2025年限制性股票激励计划），其中，2023年第二期及2025年限制性股票激励计划，以年度芯片出货量累计值进行考核，突出体现公司的研发驱动战略布局和阶段性发展重心。同时，公司拟开启2026年限制性股票激励计划，最大限度地发挥人力资源的潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。

2026年，公司将继续坚持“人才为本”理念，紧密围绕中长期发展战略，精准匹配人才需求，有序引进和培育多元化专业人才，持续完善人才梯队建设与人才发展机制；同时进一步深化与高校的战略合作，推进产学研协同创新，强化技术创新与人才培养联动，为公司高质量发展积蓄坚实人才支撑。公司将在市场及内部条件适宜时，综合运用权益类激励工具，构建员工、公司与股东利益共享、风险共担的共同体，助力企业持续健康发展。

三、强化财务管理，提升资金效率

2025年，公司实现营业收入67.93亿元，同比增长14.63%；归属于母公司净利润8.73亿元，同比增长6.21%；综合毛利率37.97%，较2024年提升1.42个百分点，盈利能力持续改善。资产负债率控制在14.67%，较2024年末上升1.92个百分点，仍保持较低水平，财务结构稳健。

在运营效率方面，公司持续优化资产管理，但受战略性备货增加影响，部分周转指标略有变化。截至2025年末，公司应收账款余额为33,484.83万元，应收账款周转天数13.74天，较2024年增加1.59天，回款周期略有延长；存货余额为252,769.74万元，存货周转天数170.52天，较2024年增加41.71天，主要系公司为应对存储市场波动及保障客户需求，实施前瞻性备货策略所致；总资产周转天数430.11天，较2024年增加7.54天。

在现金流管理方面，2025年公司经营活动产生的现金流量净额为-22,973.39万元，同比下降122.05%，主要系报告期公司预付原材料采购款增加所致；投资活动产生的现金流量净额为58,574.18万元，同比由负转正，主要系定期存款及理财

产品到期收回金额增加。截至 2025 年末，公司货币资金余额为 259,266.95 万元，交易性金融资产 40,055.15 万元，资金储备充裕。

在不影响主营业务发展的前提下，公司持续加强现金管理，合理配置和使用存量资金。2025 年度，公司及控股子公司根据董事会授权，使用额度不超过人民币 15 亿元进行自有资金委托理财，使用额度不超过 2 亿美元开展外汇套期保值业务，实现资产保值增值。

2026 年，公司将针对 2025 年运营效率指标变化，着力提升资金周转效率，具体措施如下：

1、持续加强应收账款管理

针对 2025 年应收账款周转天数增加至 13.74 天的情况，公司将完善应收账款管理流程，持续严格执行信用政策，强化账龄分析，对于账龄较高、金额大的客户加强催收，保持良好的经营活动现金流。

2、优化现金流管理，提高资金使用效率

针对 2025 年经营活动现金流净额为负的情况，公司将加强销售回款与采购付款的时序匹配，优化供应链付款账期，力争 2026 年实现经营活动现金流量净额转正；在保持 14.67%资产负债率稳健水平的基础上，合理运用财务杠杆，优化融资结构，确保公司具备充足的流动性储备以支持业务扩张需求。

同时，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买安全性高的低风险理财产品，额度不超过人民币 15 亿元；使用额度不超过 2 亿美元的自有资金和银行授信开展外汇套期保值业务，降低汇率波动风险，提升存量资金收益。

四、完善公司治理，提升规范运作水平

2025 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，规范运作，密切关注法律法规和监管政策变化，持续完善公司治理结构，提高治理效能，研究提出取消监事会、设立职工代表董事、修订《公司章程》、完

善公司治理制度等公司治理优化方案，有效提升公司可持续健康发展和管理运作水平；在三会运作方面，公司共召开股东会 2 次，董事会 9 次，董事会战略决策委员会 3 次，董事会审计委员会 7 次，董事会薪酬与考核委员会 6 次，有效发挥董事会及各专门委员会的职能；为提升“关键少数”的合规意识，公司结合市场动态、法规政策变化、监管动态等，积极组织“关键少数”参与内外部履职能力培训。

2025 年公司董事、高管多次参加专项培训，公司为独立董事和外部董事履职提供便利条件，为积极发挥相关董事在公司治理方面的作用，多次组织独立董事和外部董事来公司实地调研，就公司 2025 年经营情况进行充分沟通交流与汇报。

2026 年，公司根据《上市公司治理准则》，紧扣“强监管、防风险、促发展”主线，系统推进治理架构优化与规范运作升级：

1、统筹董事会换届工作及新一届高级管理人员的聘任工作，完善多元化董事会架构，确保新一届董事会成员在专业背景、管理经验及独立性等方面符合监管要求与公司战略发展需求，保障治理与经营的科学有序。

2、在治理架构优化方面，公司将持续依据监管要求和公司业务发展实际，进一步明确各治理主体的职责边界，强化董事会下设战略决策与 ESG、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会建设，发挥独立董事、审计委员会监督作用。

3、在制度体系完善方面，公司将持续关注最新监管规则，及时对核心治理制度开展梳理与系统性修订，确保制度条款与监管新规全面对标、无缝衔接，持续提升公司内控管理规范性和有效性。

4、在“关键少数”履职管理方面，公司将进一步强化董事及高级管理人员的忠实勤勉义务，全面落实新规对“关键少数”履职行为的细化要求。通过优化聘任合同条款，明确履职标准、过错认定依据及离职后义务，推动履职约束由“身份导向”向“契约导向”转变。同时，公司将通过加强监管培训、监管动态传递等多元路径，筑牢董事、高管等“关键少数”合规意识，提高履职能力。

五、加强投资者沟通与回报

1、提高信息披露质量

2025 年度，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《晶晨股份信息披露管理制度》履行信息披露义务，全年共计发布 156 份公告文件，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司连续 5 年披露环境、社会及治理（ESG）报告。

公司主动提升信息披露可读性，2024 年年度报告披露后及时发布“一图读懂晶晨股份 2024 年年度报告”；参与上交所“科创 3 分钟·高管开放麦 | 踏浪奋进——晶晨赋能智能‘芯’未来”活动，并在“上交所科创板之家”、“上证路演中心”公众号平台发布，通过视频、图表等可视化方式提高信息披露内容的有效性和可读性。凭借在信息披露、公司治理、投资者关系及 ESG 等方面的优秀表现，2025 年公司连续第三年获得上海证券交易所信息披露“A”级最高评级。

2026 年度，公司将继续完善可持续发展报告及管理体系，将 ESG 理念有效融入企业管理和业务运营，推动 ESG 管理向制度化、规范化、体系化方向发展。在定期报告披露后，采取业绩说明会、图文简报等可视化形式进行解读，运用通俗易懂的语言，帮助投资者更好地理解公司经营成果，积极传递公司长期投资价值。

2、深化投资者沟通

2025 年，公司始终将投资者关系管理置于重要位置，通过投资者专线、投资者邮箱及“上证 E 互动”平台等多样化渠道开展投资者关系管理工作。公司在 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告及 2025 年第三季度报告披露后分别召开业绩说明会，参加由上海证券交易所主办的“2024 年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会”、“2025 年半年度科创板芯片设计行业集体业绩说明会的公告”，积极接待投资者现场调研，2025 年合计场次 88 次，于定期报告发布后第一时间召开投资者交流会，向投资者详细解读公司业绩、分享行业动态、说明重大事项。

公司认真接听并记录投资者来电，通过“上证 E 互动”回复投资者提问并发布投资者关系活动记录表，就公司经营情况、战略规划等与投资者进行深度沟通，回

应投资者关切问题。2025年9月30日，公司披露《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，系统评估了行动方案的执行情况。

2026年度，公司将进一步深化投资者沟通力度，构建“多层次、多渠道、立体化”的投资者沟通体系。建立定期报告发布后的常态化业绩说明会机制，针对公司经营成果、财务状况及战略规划进行系统解读。

持续夯实投资者热线、邮箱、“上证E互动”平台等基础沟通渠道，进一步拓展沟通场景，通过路演、反路演、策略会及现场调研等活动，主动传递公司长期投资价值；积极探索数字化投关工具应用，便利投资者及时了解公司发展。在股东会召开中，持续采用现场投票与网络投票相结合的方式，便利中小投资者参与公司治理。对涉及中小投资者利益的重要事项，严格执行中小投资者表决单独计票并公开披露计票结果，切实保障中小投资者的知情权和参与权。

3、持续回报投资者

2025年度，基于对公司未来发展前景的信心及维护股东利益的需要，公司实际控制人自愿承诺不减持公司股份。公司积极践行“以投资者为本”的理念。

2025年度公司累计回购股份1,073,489股，回购金额7,993.57万元。2025年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2026年2月28日，公司总股本421,165,613股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,073,489股后的股本420,092,124股为基数，以此计算合计拟派发现金红利84,018,424.80元（含税）。本年度公司现金分红和回购金额合计163,954,132.89元（含税）。

六、强化管理层与股东利益共担共享

公司始终秉持“人才为本”理念，建立了健全的长效激励机制，将管理层及核心骨干利益与股东利益深度绑定。截至2025年12月31日，公司已稳步实施五期股权激励计划，分别为2019年、2021年、2023年、2023年第二期及2025年限制性股票激励计划，形成覆盖不同发展阶段、不同业务板块的股权激励体系。2025年，公司因股权激励确认的股份支付费用为0.47亿元，对归属于母公司所有者的

净利润的影响为 0.51 亿元（已考虑相关税费影响）。剔除上述股份支付费用影响, 2025 年归属于母公司所有者的净利润为 9.24 亿元。

在业绩考核机制方面, 公司建立了严格的股权激励考核体系。2025 年限制性股票激励计划以年度芯片出货量累计值作为公司业绩考核指标, 突出体现公司的研发驱动战略布局和阶段性发展重心, 要求 2025-2028 年度无线连接芯片和视觉系统芯片出货量累计值分别达到 6,628 万颗、10,240 万颗、15,650 万颗、23,760 万颗。

公司推出了 2026 年股权激励计划, 以战略新产品出货量和整体营收增长率为业绩目标, 进一步完善了管理层及核心骨干考核指标, 促进管理层与股东利益长期一致。公司将高管薪酬与公司经营效益合理挂钩, 确保薪酬变动与公司经营业绩相匹配, 与同行业情况相协调。

2026 年, 公司将进一步完善董事及高级管理人员薪酬约束机制。建立绩效薪酬追索等内部追责机制, 对因经营决策失误、重大经营风险等导致公司利益受损的情形, 依据相关规定和财产损失责任认定结果, 对相关责任人扣减或追索扣回绩效年薪和激励收入, 强化管理层责任约束。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况, 及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦经营主业, 提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力, 通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报, 切实保护投资者利益, 维护公司良好市场形象。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意相关风险。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日

指标附录

指标	2025年	2024年	2023年	2025年比上年同期增减 (%)
营业收入(亿元)	67.93	59.26	53.71	14.63
归属于母公司净利润(亿元)	8.73	8.22	4.98	6.21
加权平均净资产收益率(%)	12.66	13.87	9.41	减少1.21个百分点
销售净利润率(%)	12.85	13.87	9.27	减少1.02个百分点
资产负债率(%)	14.67	12.75	13.64	增加1.92个百分点
总资产周转天数(天)	430.11	422.57	415.26	增加7.54天
应收账款周转天数(天)	13.74	12.15	11.86	增加1.59天
存货周转天数(天)	170.52	128.81	147.59	增加41.71天 (主要系战略性备货增加)
研发费用(亿元)	15.52	13.53	12.83	14.72